

Alpha-Fry™ EGP-130

无卤化物、免清洗焊膏

描述

Alpha-Fry EGP-130 焊膏的助焊剂系统是针对精密间距无铅应用而特别配方的免清洗 RELO 类产品，在连续表面贴装印刷时可保证稳定的粘性和触变性。产品配方包括 SAC305 (96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu) 和 SAC0307 (99%Sn/0.3%Ag/0.7%Cu) 等合金配方。该产品还具有优异的耐高温预热性、抗超精密间距焊盘溶解以及降低焊球缺陷等属性。

技术规格

项目	规格
10 rpm, Malcom 粘度: 1) 89.0% 金属含量, SAC305 (96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu) / SAC0307 (99%Sn/0.3%Ag/0.7%Cu) 2) 88.5% 金属含量, SAC305 (96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu) / SAC0307 (99%Sn/0.3%Ag/0.7%Cu)	1) 1900 poise 2) 1700 poise
粉末尺寸	20 - 38µm
粘附力 (JIS-Z-3284 App.9, 24 小时)	> 100 gf
网板寿命	> 8 小时
热塌陷 (JIS-Z-3284 App.8)	合格, 不接触;
焊接残留颜色	无色透明
焊球测试 (JIS-Z-3284 App.11)	合格, 聚合水平: 1
卤化物含量	无卤化物
腐蚀性测试 (JIS-Z-3284 App.4, 助焊剂残留)	合格, 无颜色变化
铜镜腐蚀性测试 (JIS-Z-3197, 8.4.2)	合格, 无铜剥落
铬酸银试纸测试 (JIS-Z-3197, 8.1.4.2.3)	合格, 无颜色变化
迁移测试 (JIS-Z-3284 App.14)	合格, >1X10 ⁹ ohm
表面绝缘阻抗 (IPC J-STD 004B)	合格, >1X10 ⁹ ohm
表面绝缘阻抗 (Bellcore GR-78-CORE)	合格, >1X10 ¹⁰ ohm
润湿/不润湿测试 (JIS-Z-3284 App.10)	合格; 铜片, 2 级;
产品保存寿命 (存储条件: 0 - 10°C; 使用前开盖升温至室温)	6 个月(由生产日期起)
产品包装规格	500gm 罐装

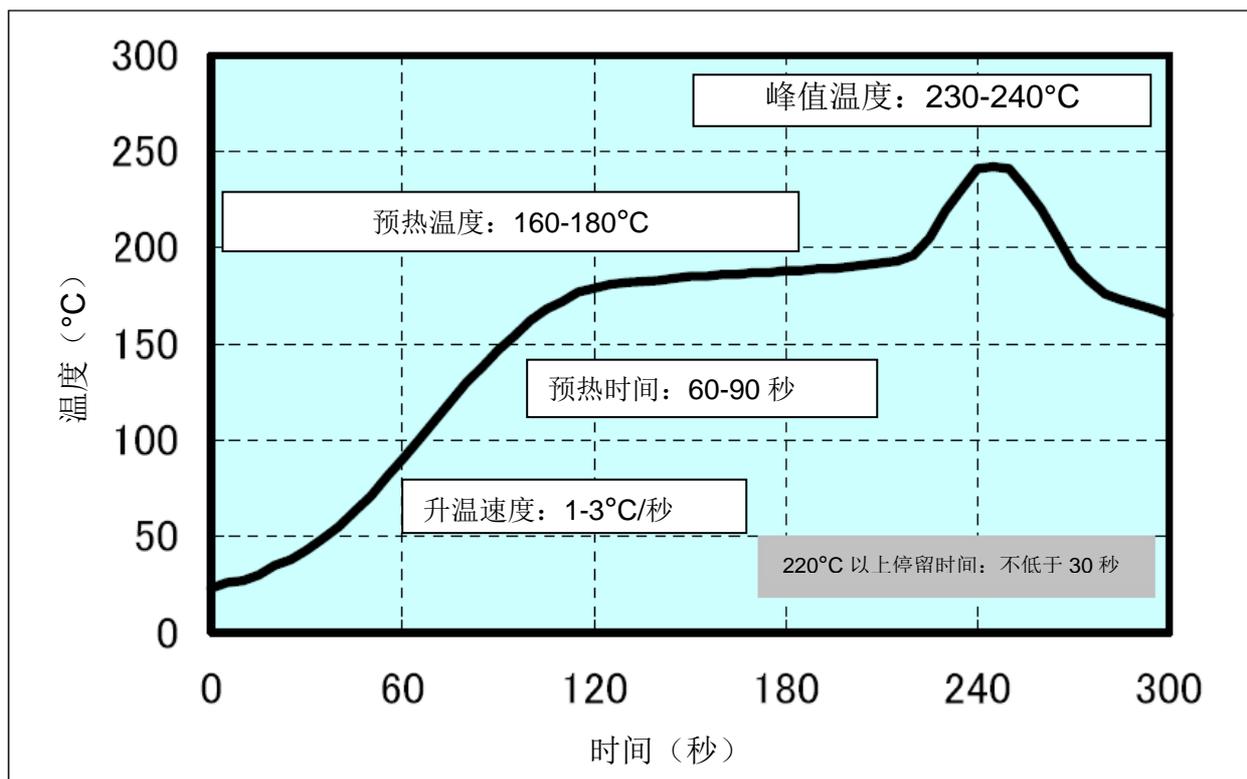
应用

印刷*
<ul style="list-style-type: none"> - 刮刀压力: 0.15 - 0.25 kg/cm - 挤压速度: 10-50 mm/s - 焊膏滚动直径: 1.5-2.0 cm - 分离速度: 1-20 mm/s - 刮刀提升高度: 10-15 mm

*网板厚度: 0.10mm - 0.15 mm (4 - 6 mil), 间距 0.4 - 0.5 mm (0.016" - 0.020")

回流
<ul style="list-style-type: none"> - 干燥空气或氮气 - 开始升温速度: 1 - 3°C/秒; - 160 - 180° C 保温时间: 60-90 秒 - 液相点以上停留时间: 30 秒 - 峰值温度: 230-240°C - 冷却速度: 3-7°C/秒

图 1. Alpha-Fry EGP-130 (SAC305 和 SAC0307 合金) 典型空气环境回流曲线



注:这个曲线已于实验室进行过测试,证实可行并且成功熔合。然而,使用者仍需要对于每个线路板应用进行优化设置,以确保达至最佳效果。

健康和安全性

遵守标准的操作使用规范,如在通风良好的使用环境以及避免长时间或反复的皮肤接触。穿戴合适的防护工装能有效防止与皮肤和眼睛接触

欲了解更多信息,请参考材料安全数据表。